

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2022《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共9项，其中自主可控A级0项、B级9项、C级0项、C^{*}级0项、D级0项、E级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用IP核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2025年03月29日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	电源基准	TLX3112-3.3XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	电源基准	TLX3112-3.0XSF3	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	逻辑门	TLX1G08XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	逻辑门	TLX1G08XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	逻辑门	TLX1G126XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	逻辑门	TLX1G126XC5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
7	门电路	TLX1G32XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
8	门电路	TLX1G14XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
9	LDO	TLX7172	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

填报单位

法定代表人（签章）： 沈春雷

填表人（签字）： 沈春雷

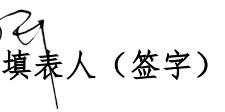
电话： 18221090182

填报日期： 20250329

- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- ^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- ^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位

法定代表人（签章）： 填表人（签字）： 姜春雷 电话：18221090182 填报日期：20250329

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^g		备注
			名称	类型	来源单位	境内/ 境外	名称	是否“核心”/ “关键” ^e	来源单位 ^f	境内/ 境外	工艺名称	境内/ 境外	
1	电源基准	TLX3112-3.3XSF3	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	南通通富 微电子有限公司				
							键合丝	否	南通通富 微电子有限公司				
							塑封料	否	南通通富 微电子有限公司				
2	电源基准	TLX3112-3.0XSF3	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	南通通富 微电子有限公司				
							键合丝	否	南通通富 微电子有限公司				
							塑封料	否	南通通富 微电子有限公司				
3	逻辑门	TLX1G08X75	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.5 CMOS	境内	
							框架	否	南通金茂电子 科技有限公司				

填报单位

法定代表人(签章) : 沙春雷

填表人(签字) : 喻春雷

电话: 18221090182

填报日期: 20250329

							键合丝	否	南通金茂电子 科技有限公司				
							塑封料	否	南通金茂电子 科技有限公司				
4	逻辑门	TLX1G08XC5	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.5 CMOS	境内	
							框架	否	南通金茂电子 科技有限公司				
							键合丝	否	南通金茂电子 科技有限公司				
							塑封料	否	南通金茂电子 科技有限公司				
5	逻辑门	TLX1G126XF5	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	南通通富 微电子有限公司				
							键合丝	否	南通通富 微电子有限公司				
							塑封料	否	南通通富 微电子有限公司				
6	逻辑门	TLX1G126XC5	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	南通通富 微电子有限公司				
							键合丝	否	南通通富 微电子有限公司				

填报单位

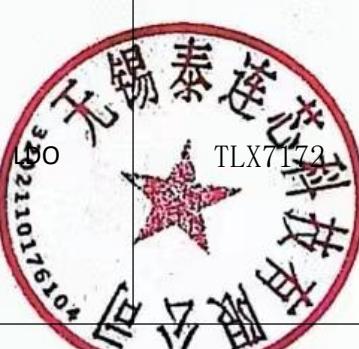
法定代表人(签章) : 沈春雷

填表人(签字) : 喻春雷

电话: 18221090182

填报日期: 20250329



							塑封料	否	南通通富 微电子有限公司				
7	逻辑门	TLX1G32XF5	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							键合丝	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							塑封料	否	江苏长电科技 股份有限公司				
8	逻辑门	TLX1G14XF5	/	/	/	/	晶圆	关键	无锡华润上华 科技有限公司	境内	0.18um CMOS	境内	
							框架	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							键合丝	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							塑封料	否	江苏长电科技 股份有限公司				
9			/	/	/	/	晶圆	关键	中芯国际集成电路制 造(上海)有限公司	境内	0.18umBCD	境内	
							框架	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							键合丝	否	江苏长电科技 股份有限公司				
							塑封料	否	江苏长电科技 股份有限公司				

填报单位

法定代表人(签章) : 沈春雷 填表人(签字) : 沈春雷 电话: 18221090182

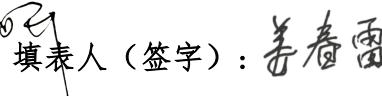
填报日期: 20250329

填表说明：

- a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- b. 应填写元器件完整型号规格；
- c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位

法定代表人（签章）： 填表人（签字）： 电话：18221090182 填报日期：20250329